

2026 年 8 月 19 日

各 位

公司名 尼得科精密检测科技株式会社

代表人 董事长总经理 山崎 秀和

地 址 京都府向日市 Nidec Park 33 番地 C 栋

## 关于尼得科精密检测科技参展 THECA Show 2026

尼得科精密检测科技株式会社（以下简称“本公司”）将参展 2026 年 8 月 26 日（周三）～8 月 28 日（周五）在曼谷 International Trade & Exhibition Centre (BITEC) 举办的“THAILAND ELECTRONICS CIRCUIT ASIA 2026”（THECA）。



本次展会由泰国印制电路板协会（Thailand Printed Circuit Association）主办，是聚焦印制电路板（PCB）、电路板组装（PCBA）领域、面向泰国电子制造行业的国际性专业展会。

本公司展台将针对当下日趋高密度、复杂化的线路板产品，提供覆盖检测治具探针、内部缺陷检测全流程的一体化品质管控解决方案。本公司高可靠性电气检测设备可高效处理高密度板、多层板，实现高效顺畅的生产流程；定制化高精度治具能保障稳定接触、杜绝误判，大幅提升整条产线的检测效率。此外，本次我们将在泰国首次展出由我司与 Technohorizon 株式会社共同开发的全新 X 射线检测设备，该设备可清晰检测复杂电子元器件与电路板内部结构。

### 〈参展概要〉

- ・展期：2026 年 8 月 26 日（周三）～28 日（周五）
- ・展馆：曼谷 International Trade & Exhibition Centre
- ・展位：R13
- ・官网：<https://thailandelectronicscircuitasia.com/>

### 〈核心参展产品〉

- ・背钻检测专用高速 CT 型 X 射线检测设备
- ・适配 HDI/PCB 印制电路板的导通/短路检测设备“STAR REC®系列”
- ・面向半导体封装的导通/短路检测设备“GATS®系列”

- 大尺寸电路板专用导通/短路检测设备 “GATS®8360 系列”
- 2D/3D wafer Bump 检测设备 “RWi-300MK3”
- 3D/AFVI AI 检测系统 “AURCA Series”
- 适配高密度电路板的光学 2D/3D 检测设备 “RSH 系列”
- 高精度检测治具